

证券代码:688141 证券简称:杰华特 公告编号:2024-024

杰华特微电子股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杰华特微电子股份有限公司(以下简称“杰华特”、“公司”)于2024年5月31日分别召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,同意公司根据当前募集资金使用(以下简称“募投项目”)的实际运行情况对部分募投项目内部投资结构进行调整,本次调整募集资金投向不涉及募集资金总额和募集资金用途。本事项在董事会审议批准范围内,无需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核意见》,公司于2023年12月公开发行人民币普通股58,080,000股,每股面值人民币1元,发行价格为人民币18.26元,募集资金总额为人民币2,222,140,800.00元,扣除发行费用(不含增值税进项税额)人民币167,455,870.32元后,募集资金净额为人民币2,054,684,929.68元。上述募集资金实际到账时间为2022年12月20日,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具并盖章了天健信202219号《杰华特微电子股份有限公司验资报告》。公司按照对募集资金采取了专户管理,并与保荐机构和中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	高性能电源管理芯片研发及产业化项目	39,104.84	31,104.84
2	模拟芯片研发及产业化项目	43,970.59	43,970.59
3	汽车电子芯片研发及产业化项目	30,954.87	30,954.87
4	先进半导体工艺平台开发项目	21,064.43	21,064.43
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
	合计	165,094.73	157,094.73

“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”实施以来,严格按照项目整体目标推进,受到了工程技术人员及一线生产人员的大力支持,新建技术方案无法充分保障公司项目建设及后续经营,为了更好地保障项目顺利实施,公司使用募集资金增加高性能电源管理芯片研发及产业化项目“投资规模”,具体内容详见《关于使用募集资金增加募投项目投资规模增加部分募投项目实施主体变更的公告》(公告编号:2024-011)。

2024年4月28日,公司召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十八次会议,审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构和增加部分募投项目实施主体的议案》,2024年5月31日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构和增加部分募投项目实施主体变更的议案》,经股东大会审议通过,公司“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”投资规模由39,104.84万元增加至49,104.84万元,相关投资的具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	高性能电源管理芯片研发及产业化项目	49,104.84	41,104.84
2	模拟芯片研发及产业化项目	43,970.59	43,970.59
3	汽车电子芯片研发及产业化项目	30,954.87	30,954.87
4	先进半导体工艺平台开发项目	21,064.43	21,064.43
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
	合计	175,094.73	167,094.73

致使原募集资金增加募投项目投资规模,截至2024年4月30日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划和投资进度如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	募集资金累计投入	募集资金投资进度
1	高性能电源管理芯片研发及产业化项目	49,104.84	41,104.84	21,138.36	51.47%
2	模拟芯片研发及产业化项目	43,970.59	43,970.59	10,351.52	23.54%
3	汽车电子芯片研发及产业化项目	30,954.87	30,954.87	7,389.50	23.87%
4	先进半导体工艺平台开发项目	21,064.43	21,064.43	5,219.63	24.78%
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,079.47	100.26%
	合计	175,094.73	167,094.73	74,948.48	44.41%

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

为保障募投项目顺利实施,提高资金使用效率,结合公司的实际情况,在募投项目总资金额、募集资金投资用途不发生变更的情况下,公司对调整部分募投项目的内部投资结构,具体情况如下:

(一)“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的情况

“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	募集资金累计投入	募集资金投资进度
1	高性能电源管理芯片研发及产业化项目	49,104.84	41,104.84	21,138.36	51.47%
2	模拟芯片研发及产业化项目	43,970.59	43,970.59	10,351.52	23.54%
3	汽车电子芯片研发及产业化项目	30,954.87	30,954.87	7,389.50	23.87%
4	先进半导体工艺平台开发项目	21,064.43	21,064.43	5,219.63	24.78%
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,079.47	100.26%
	合计	175,094.73	167,094.73	74,948.48	44.41%

二、内部投资结构调整的原因

公司“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的研发及产业化项目的工作完成时间较早,公司结合募投项目建设的实际情况,科学合理地对内部投资结构进行调整,有助于本项目募集资金使用效率的提升,保障本项目的顺利实施。本项目内部投资结构调整的具体情况如下:

(1)建设投资中的硬件设备购置减少主要系募投项目的研发投入设备采购发生变化所致。公司目前在产产品经过研发,已通过可靠性测试进行了集成后用于专用设备销售,经公司内部审核,同等规格性能优于外部采购,公司选择自主采购,采购价格更低,且自主采购设备研发及生产阶段的设备购置费用更低,预计10%的成本节约金额达1,500万元,导致资产购置有所减少。

(2)新增开发投资中的人工费用增加主要由根据市场环境,募投项目实施情况及未来资金投入规划,科学合理地对内部投资结构进行调整,有助于本项目募集资金使用效率的提升,保障本项目的顺利实施。本项目内部投资结构调整的具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	募集资金累计投入	募集资金投资进度
1	高性能电源管理芯片研发及产业化项目	49,104.84	41,104.84	21,138.36	51.47%
2	模拟芯片研发及产业化项目	43,970.59	43,970.59	10,351.52	23.54%
3	汽车电子芯片研发及产业化项目	30,954.87	30,954.87	7,389.50	23.87%
4	先进半导体工艺平台开发项目	21,064.43	21,064.43	5,219.63	24.78%
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,079.47	100.26%
	合计	175,094.73	167,094.73	74,948.48	44.41%

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

为保障募投项目顺利实施,提高资金使用效率,结合公司的实际情况,在募投项目总资金额、募集资金投资用途不发生变更的情况下,公司对调整部分募投项目的内部投资结构,具体情况如下:

(一)“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的情况

“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	募集资金累计投入	募集资金投资进度
1	高性能电源管理芯片研发及产业化项目	49,104.84	41,104.84	21,138.36	51.47%
2	模拟芯片研发及产业化项目	43,970.59	43,970.59	10,351.52	23.54%
3	汽车电子芯片研发及产业化项目	30,954.87	30,954.87	7,389.50	23.87%
4	先进半导体工艺平台开发项目	21,064.43	21,064.43	5,219.63	24.78%
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,079.47	100.26%
	合计	175,094.73	167,094.73	74,948.48	44.41%

二、内部投资结构调整的原因

公司“汽车电子芯片研发及产业化项目”的可行性分析工作完成时间较早,公司结合募投项目建设的实际情况,科学合理地对内部投资结构进行调整,有助于本项目募集资金使用效率的提升,保障本项目的顺利实施。本项目内部投资结构调整的具体情况如下:

(1)新增开发投资中的人工费用增加主要由根据市场环境,募投项目实施情况及未来资金投入规划,科学合理地对内部投资结构进行调整,有助于本项目募集资金使用效率的提升,保障本项目的顺利实施。本项目内部投资结构调整的具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	募集资金累计投入	募集资金投资进度
1	高性能电源管理芯片研发及产业化项目	49,104.84	41,104.84	21,138.36	51.47%
2	模拟芯片研发及产业化项目	43,970.59	43,970.59	10,351.52	23.54%
3	汽车电子芯片研发及产业化项目	30,954.87	30,954.87	7,389.50	23.87%
4	先进半导体工艺平台开发项目	21,064.43	21,064.43	5,219.63	24.78%
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,079.47	100.26%
	合计	175,094.73	167,094.73	74,948.48	44.41%

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

为保障募投项目顺利实施,提高资金使用效率,结合公司的实际情况,在募投项目总资金额、募集资金投资用途不发生变更的情况下,公司对调整部分募投项目的内部投资结构,具体情况如下:

(一)“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的情况

“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	募集资金累计投入	募集资金投资进度
1	高性能电源管理芯片研发及产业化项目	49,104.84	41,104.84	21,138.36	51.47%
2	模拟芯片研发及产业化项目	43,970.59	43,970.59	10,351.52	23.54%
3	汽车电子芯片研发及产业化项目	30,954.87	30,954.87	7,389.50	23.87%
4	先进半导体工艺平台开发项目	21,064.43	21,064.43	5,219.63	24.78%
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,079.47	100.26%
	合计	175,094.73	167,094.73	74,948.48	44.41%

二、内部投资结构调整的原因

公司“汽车电子芯片研发及产业化项目”的可行性分析工作完成时间较早,公司结合募投项目建设的实际情况,科学合理地对内部投资结构进行调整,有助于本项目募集资金使用效率的提升,保障本项目的顺利实施。本项目内部投资结构调整的具体情况如下:

(1)新增开发投资中的人工费用增加主要由根据市场环境,募投项目实施情况及未来资金投入规划,科学合理地对内部投资结构进行调整,有助于本项目募集资金使用效率的提升,保障本项目的顺利实施。本项目内部投资结构调整的具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	募集资金累计投入	募集资金投资进度
1	高性能电源管理芯片研发及产业化项目	49,104.84	41,104.84	21,138.36	51.47%
2	模拟芯片研发及产业化项目	43,970.59	43,970.59	10,351.52	23.54%
3	汽车电子芯片研发及产业化项目	30,954.87	30,954.87	7,389.50	23.87%
4	先进半导体工艺平台开发项目	21,064.43	21,064.43	5,219.63	24.78%
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,079.47	100.26%
	合计	175,094.73	167,094.73	74,948.48	44.41%

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

为保障募投项目顺利实施,提高资金使用效率,结合公司的实际情况,在募投项目总资金额、募集资金投资用途不发生变更的情况下,公司对调整部分募投项目的内部投资结构,具体情况如下:

(一)“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的情况

“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	募集资金累计投入	募集资金投资进度
1	高性能电源管理芯片研发及产业化项目	49,104.84	41,104.84	21,138.36	51.47%
2	模拟芯片研发及产业化项目	43,970.59	43,970.59	10,351.52	23.54%
3	汽车电子芯片研发及产业化项目	30,954.87	30,954.87	7,389.50	23.87%
4	先进半导体工艺平台开发项目	21,064.43	21,064.43	5,219.63	24.78%
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,079.47	100.26%
	合计	175,094.73	167,094.73	74,948.48	44.41%

二、内部投资结构调整的原因

公司“汽车电子芯片研发及产业化项目”的可行性分析工作完成时间较早,公司结合募投项目建设的实际情况,科学合理地对内部投资结构进行调整,有助于本项目募集资金使用效率的提升,保障本项目的顺利实施。本项目内部投资结构调整的具体情况如下:

(1)新增开发投资中的人工费用增加主要由根据市场环境,募投项目实施情况及未来资金投入规划,科学合理地对内部投资结构进行调整,有助于本项目募集资金使用效率的提升,保障本项目的顺利实施。本项目内部投资结构调整的具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	募集资金累计投入	募集资金投资进度
1	高性能电源管理芯片研发及产业化项目	49,104.84	41,104.84	21,138.36	51.47%
2	模拟芯片研发及产业化项目	43,970.59	43,970.59	10,351.52	23.54%
3	汽车电子芯片研发及产业化项目	30,954.87	30,954.87	7,389.50	23.87%
4	先进半导体工艺平台开发项目	21,064.43	21,064.43	5,219.63	24.78%
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,079.47	100.26%
	合计	175,094.73	167,094.73	74,948.48	44.41%

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

为保障募投项目顺利实施,提高资金使用效率,结合公司的实际情况,在募投项目总资金额、募集资金投资用途不发生变更的情况下,公司对调整部分募投项目的内部投资结构,具体情况如下:

(一)“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的情况

“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	募集资金累计投入	募集资金投资进度
1	高性能电源管理芯片研发及产业化项目	49,104.84	41,104.84	21,138.36	51.47%
2	模拟芯片研发及产业化项目	43,970.59	43,970.59	10,351.52	23.54%
3	汽车电子芯片研发及产业化项目	30,954.87	30,954.87	7,389.50	23.87%
4	先进半导体工艺平台开发项目	21,064.43	21,064.43	5,219.63	24.78%
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,079.47	100.26%
	合计	175,094.73	167,094.73	74,948.48	44.41%

二、内部投资结构调整的原因

公司“汽车电子芯片研发及产业化项目”的可行性分析工作完成时间较早,公司结合募投项目建设的实际情况,科学合理地对内部投资结构进行调整,有助于本项目募集资金使用效率的提升,保障本项目的顺利实施。本项目内部投资结构调整的具体情况如下:

(1)新增开发投资中的人工费用增加主要由根据市场环境,募投项目实施情况及未来资金投入规划,科学合理地对内部投资结构进行调整,有助于本项目募集资金使用效率的提升,保障本项目的顺利实施。本项目内部投资结构调整的具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	募集资金累计投入	募集资金投资进度
1	高性能电源管理芯片研发及产业化项目	49,104.84	41,104.84	21,138.36	51.47%
2	模拟芯片研发及产业化项目	43,970.59	43,970.59	10,351.52	23.54%
3	汽车电子芯片研发及产业化项目	30,954.87	30,954.87	7,389.50	23.87%
4	先进半导体工艺平台开发项目	21,064.43	21,064.43	5,219.63	24.78%
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,079.47	100.26%
	合计	175,094.73	167,094.73	74,948.48	44.41%

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

为保障募投项目顺利实施,提高资金使用效率,结合公司的实际情况,在募投项目总资金额、募集资金投资用途不发生变更的情况下,公司对调整部分募投项目的内部投资结构,具体情况如下:

(一)“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的情况

“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	募集资金累计投入	募集资金投资进度
1	高性能电源管理芯片研发及产业化项目	49,104.84	41,104.84	21,138.36	51.47%
2	模拟芯片研发及产业化项目	43,970.59	43,970.59	10,351.52	23.54%
3	汽车电子芯片研发及产业化项目	30,954.87	30,954.87	7,389.50	23.87%
4	先进半导体工艺平台开发项目	21,064.43	21,064.43	5,219.63	24.78%
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,079.47	100.26%
	合计	175,094.73	167,094.73	74,948.48	44.41%

二、内部投资结构调整的原因

公司“汽车电子芯片研发及产业化项目”的可行性分析工作完成时间较早,公司结合募投项目建设的实际情况,科学合理地对内部投资结构进行调整,有助于本项目募集资金使用效率的提升,保障本项目的顺利实施。本项目内部投资结构调整的具体情况如下:

(1)新增开发投资中的人工费用增加主要由根据市场环境,募投项目实施情况及未来资金投入规划,科学合理地对内部投资结构进行调整,有助于本项目募集资金使用效率的提升,保障本项目的顺利实施。本项目内部投资结构调整的具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	募集资金累计投入	募集资金投资进度
1	高性能电源管理芯片研发及产业化项目	49,104.84	41,104.84	21,138.36	51.47%
2	模拟芯片研发及产业化项目	43,970.59	43,970.59	10,351.52	23.54%
3	汽车电子芯片研发及产业化项目	30,954.87	30,954.87	7,389.50	23.87%
4	先进半导体工艺平台开发项目	21,064.43	21,064.43	5,219.63	24.78%
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,079.47	100.26%
	合计	175,094.73	167,094.73	74,948.48	44.41%

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

为保障募投项目顺利实施,提高资金使用效率,结合公司的实际情况,在募投项目总资金额、募集资金投资用途不发生变更的情况下,公司对调整部分募投项目的内部投资结构,具体情况如下:

(一)“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的情况

“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	募集资金累计投入	募集资金投资进度
1	高性能电源管理芯片研发及产业化项目	49,104.84	41,104.84	21,138.36	51.47%
2	模拟芯片研发及产业化项目	43,970.59	43,970.59	10,351.52	23.54%
3	汽车电子芯片研发及产业化项目	30,954.87	30,954.87	7,389.50	23.87%
4	先进半导体工艺平台开发项目	21,064.43	21,064.43	5,219.63	24.78%
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,079.47	100.26%
	合计	175,094.73	167,094.73	74,948.48	44.41%

二、内部投资结构调整的原因

公司“汽车电子芯片研发及产业化项目”的可行性分析工作完成时间较早,公司结合募投项目建设的实际情况,科学合理地对内部投资结构进行调整,有助于本项目募集资金使用效率的提升,保障本项目的顺利实施。本项目内部投资结构调整的具体情况如下:

(1)新增开发投资中的人工费用增加主要由根据市场环境,募投项目实施情况及未来资金投入规划,科学合理地对内部投资结构进行调整,有助于本项目募集资金使用效率的提升,保障本项目的顺利实施。本项目内部投资结构调整的具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	募集资金累计投入	募集资金投资进度
1	高性能电源管理芯片研发及产业化项目	49,104.84	41,104.84	21,138.36	51.47%
2	模拟芯片研发及产业化项目	43,970.59	43,970.59	10,351.52	23.54%
3	汽车电子芯片研发及产业化项目	30,954.87	30,954.87	7,389.50	23.87%
4	先进半导体工艺平台开发项目	21,064.43	21,064.43	5,219.63	24.78%
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,079.47	100.26%
	合计	175,094.73	167,094.73	74,948.48	44.41%

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

为保障募投项目顺利实施,提高资金使用效率,结合公司的实际情况,在募投项目总资金额、募集资金投资用途不发生变更的情况下,公司对调整部分募投项目的内部投资结构,具体情况如下:

(一)“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的情况

“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	募集资金累计投入	募集资金投资进度
1	高性能电源管理芯片研发及产业化项目	49,104.84	41,104.84	21,138.36	51.47%
2	模拟芯片研发及产业化项目	43,970.59	43,970.59	10,351.52	23.54%
3	汽车电子芯片研发及产业化项目	30,954.87			